

电子

周跟踪 (20240715-20240721)

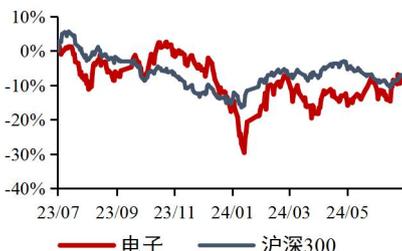
领先大市-A(维持)

美拟对华芯片贸易实施更严厉管制, 台积电 FY24Q2 业绩超预期

2024年7月22日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源: 最闻

相关报告:

【山证电子】台积电上调先进制程报价, AI 驱动半导体行业规模持续提升-山西证券电子行业周跟踪 2024.7.15

【山证电子】AI 手机时代即将来临 软硬件迎来新一轮创新周期-AI 手机行业深度 2024.7.15

分析师:

高宇洋

执业登记编码: S0760523050002

邮箱: gaoyuyang@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体:** 本周 (2024.07.15-07.19) 市场整体上涨, 上证指数涨 0.37%, 深圳成指涨 0.56%, 创业板指数涨 2.49%, 科创 50 涨 4.33%, 申万电子指数涨 0.46%, Wind 半导体指数涨 3.76%, 外围市场费城半导体指数跌 8.80%, 台湾半导体指数跌 6.42%。细分板块中, 周涨跌幅前三为半导体设备 (+8.8%)、分立器件 (+7.3%)、模拟芯片设计 (+5.4%)。从个股看, 涨幅前五为: 晶赛科技 (+56.66%)、驰诚股份 (+41.89%)、则成电子 (+41.51%)、寒武纪-U (+34.6%)、*ST 同洲 (+23.93%); 跌幅前五为: ST 旭电 (-23.08%)、ST 东旭 B (-20.41%)、南亚新材 (-17.76%)、朝阳科技 (-17.53%)、博硕科技 (-16.96%)。

➢ **行业新闻:** 美拟对华芯片贸易实施更严厉管制。彭博社报道称, 拜登政府正在考虑进行全面打击向中国出口关键芯片制造设备的公司。据悉, 美国正在向日本和荷兰施压, 称如果东京电子和 ASML 等公司继续向中国提供先进半导体技术, 美国将考虑采取最严厉的贸易限制措施。**ASML 发布 FY2024Q2 财报。** ASML 24Q2 净销售额 62.4 亿欧元, 高于预期 60.3 亿欧元。净利润 15.8 亿欧元, 高于预期 14.3 亿欧元, 同比-18.7%, 但较上季度跌幅有所收窄。Q2 订单总额上涨至 55.7 亿欧元, 同比增长超 24% 以上, 其中 25 亿欧元来自极紫外光刻 (EUV) 系统。公司预计 2024 年总净销售额将与 2023 年相似。**台积电发布 FY2024Q2 财报。** 24Q2 营收 208 亿美元, 同比+40%, 环比+14%, 主要原因是 3nm 和 5nm 出货量增长, 但智能手机季节性疲弱一定程度抵消了先进制程的增长。Q2 毛利率 53.2%, 超出公司此前指引上限, 同比-0.9pcts, 环比+0.1pcts。公司 3nm/5nm/7nm 制程营收占比分别为 15%/35%/17% (24Q1 分别为 9%/37%/19%), 先进制程合计占比 67% (24Q1 为 65%)。得益于 AI 和高端智能手机的强劲需求, 2024 年下半年 3nm 和 5nm 的产能利用率会继续上升。

➢ **重要公告:** 【甬矽电子】发布股权激励计划草案, 拟授予的限制性股票数量为 331.20 万股, 约占草案公告时公司股本总额 40,841.24 万股的 0.81%。【江波龙】预计 2024 年上半年累计归属于母公司所有者的净利润 5.20 亿元至 6.10 亿元, 上年同期净亏损 5.96 亿元, 同比扭亏为盈。【清溢光电】预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8650 万元到 9250 万元, 与上年同期相比, 预计增加 3313.38 万元到 3913.38 万元, 同比增长 62.09%到 73.33%。

投资建议

➢ 鉴于美国拟对华芯片贸易实施更严厉管制, 半导体供应链的不确定性增加, 我国对半导体产业的自主可控需求愈发迫切, 从芯片设计、制造到封装测试, 整个产业链的国产进程将得到加速。建议关注设备、材料、零部件的国产替代, AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求, 及 AI 手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

➢ **风险提示**

下游需求回暖不及预期, 技术突破不及预期, 产能瓶颈, 外部制裁升级。



目录

1. 行情回顾.....	4
1.1 市场整体行情.....	4
1.2 细分板块行情.....	4
1.2.1 涨跌幅.....	4
1.2.2 估值.....	5
1.3 个股公司行情.....	6
2. 数据跟踪.....	6
3. 新闻公告.....	9
3.1 重大事项.....	9
3.2 行业新闻.....	10
4. 风险提示.....	11

图表目录

图 1: 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	4
图 2: 周涨跌幅半导体设备、分立器件、模拟芯片设计表现领先.....	4
图 3: 月涨跌幅数字芯片设计、半导体设备、元件表现领先 (30 日滚动)	5
图 4: 年初至今涨跌幅元件、半导体设备、数字芯片设计表现领先.....	5
图 5: 多数板块当前 P/E 在历史平均值附近.....	5
图 6: 多数板块当前 P/B 低于历史平均值.....	5
图 7: 本周个股涨幅前五.....	6
图 8: 本周个股跌幅前五.....	6
图 9: 全球半导体月度销售额及增速.....	6



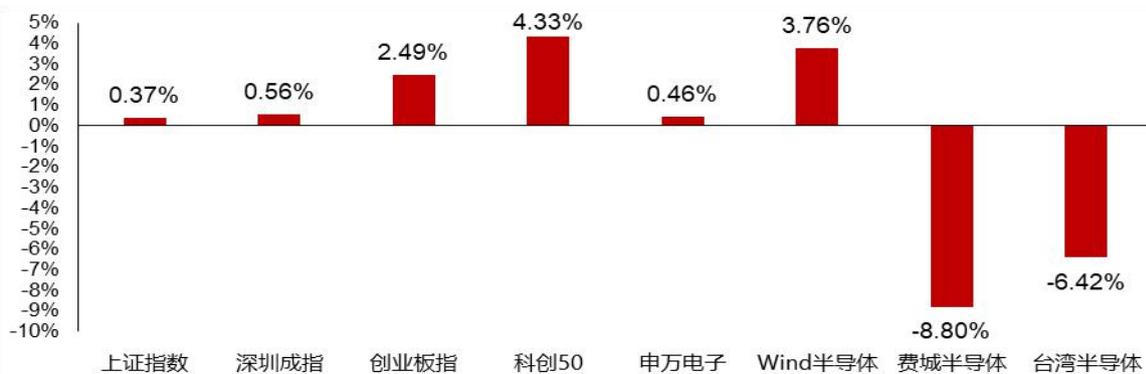
图 10: 分地区半导体销售额.....	6
图 11: 中国集成电路行业进口情况.....	7
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	7
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	7
图 14: 北美半导体设备销售额.....	7
图 15: 日本半导体设备销售额.....	7
图 16: 全球硅片出货面积.....	7
图 17: NAND 现货平均价.....	8
图 18: DRAM 现货均价.....	8
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	8
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	8
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	8
图 22: 晶圆厂稼动率 (%)	9
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)	9
表 1: 本周重大事项.....	9
表 2: 本周重要行业新闻.....	10

1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2024.07.15-07.19）市场整体上涨，上证指数涨 0.37%，深圳成指涨 0.56%，创业板指数涨 2.49%，科创 50 涨 4.33%，申万电子指数涨 0.46%，Wind 半导体指数涨 3.76%，外围市场费城半导体指数跌 8.80%，台湾半导体指数跌 6.42%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

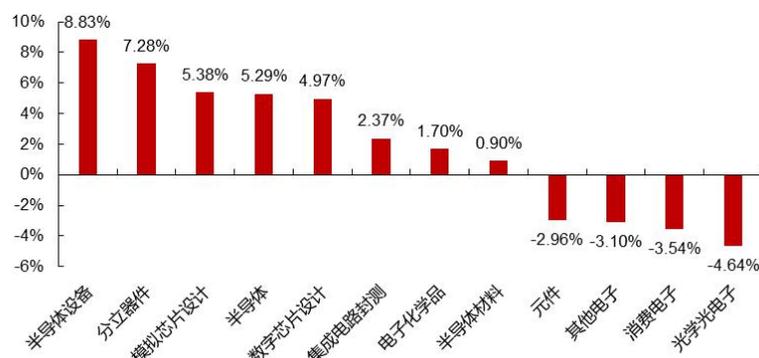


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

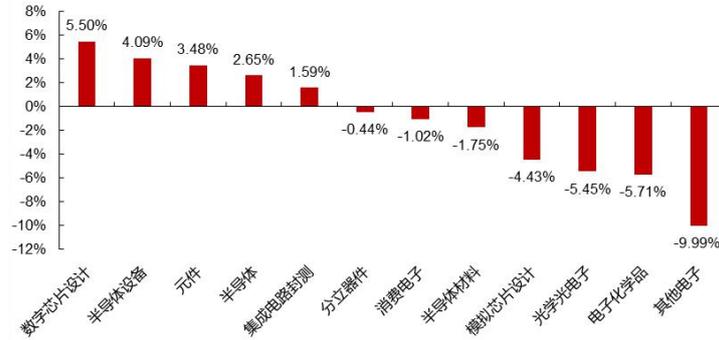
1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅半导体设备、分立器件、模拟芯片设计表现领先



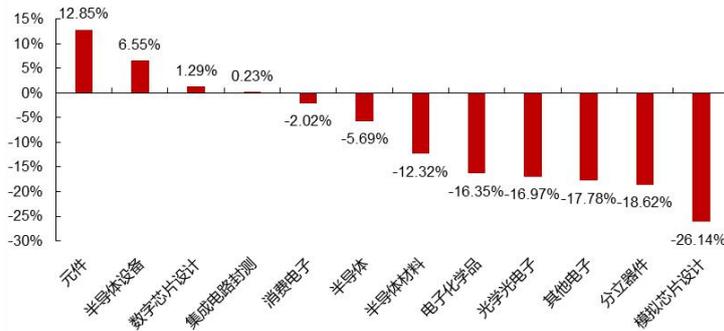
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 3：月涨跌幅数字芯片设计、半导体设备、元件表现领先（30 日滚动）



资料来源：Wind，山西证券研究所

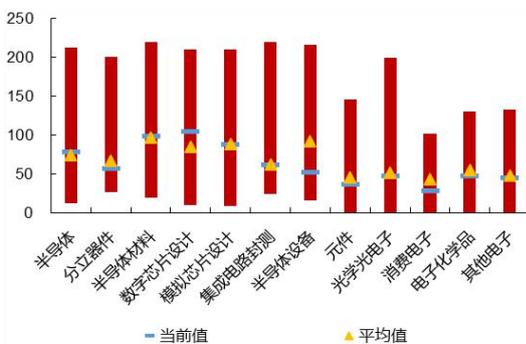
图 4：年初至今涨跌幅元件、半导体设备、数字芯片设计表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

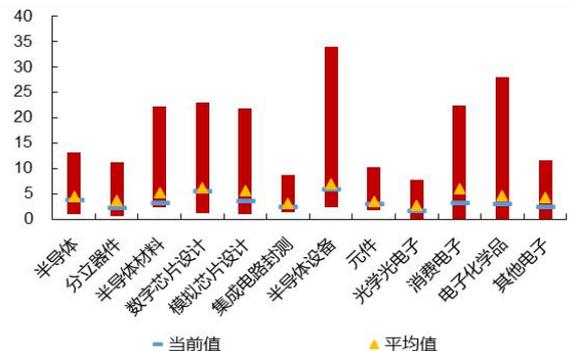
1.2.2 估值

图 5：多数板块当前 P/E 在历史平均值附近



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 低于历史平均值

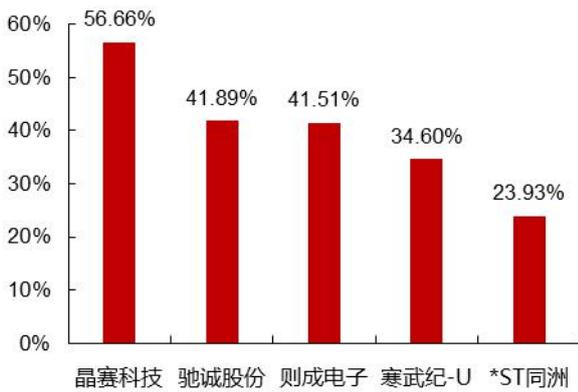


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.3 个股公司行情

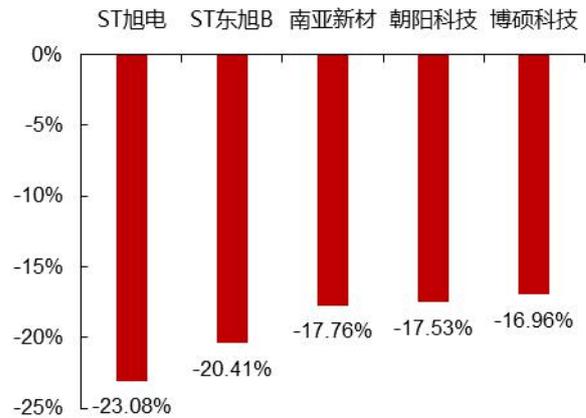
从个股情况看，晶赛科技、驰诚股份、则成电子、寒武纪-U、*ST 同洲涨幅领先，涨幅分别为+56.66%、+41.89%、+41.51%、+34.60%、+23.93%；ST 旭电、ST 东旭 B、南亚新材、朝阳科技、博硕科技跌幅居前，跌幅分别为-23.08%、-20.41%、-17.76%、-17.53%、-16.96%。

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

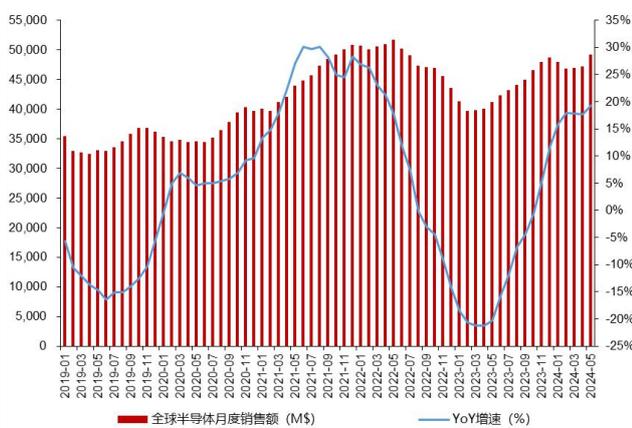
图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

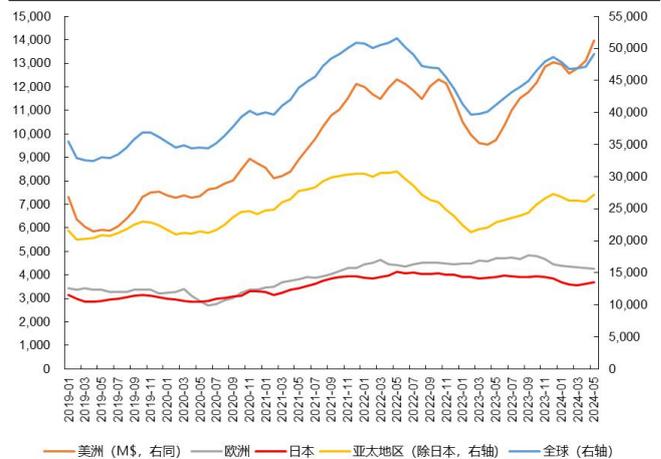
2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



资料来源：WSTS，山西证券研究所

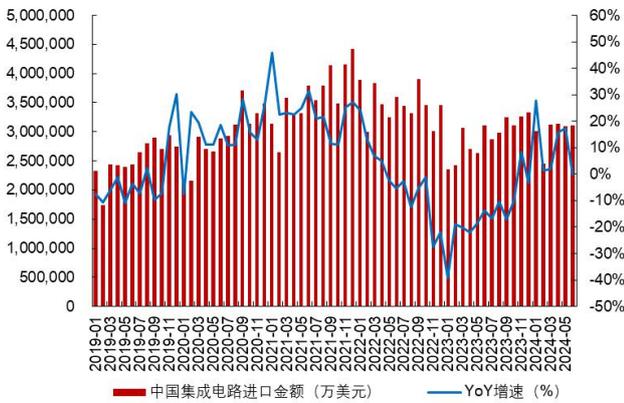
图 10：分地区半导体销售额



资料来源：WSTS，山西证券研究所

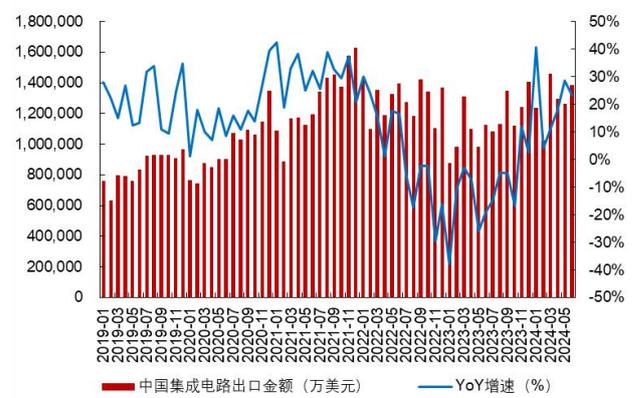


图 11：中国集成电路行业进口情况



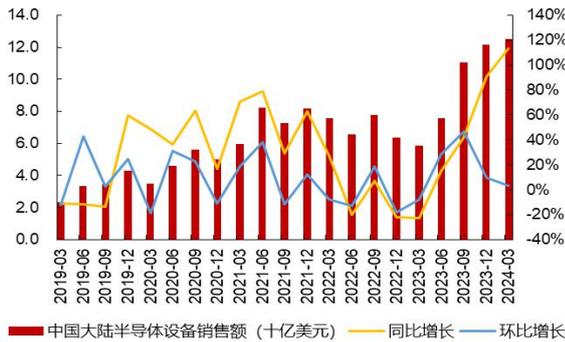
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 12：中国集成电路行业出口情况



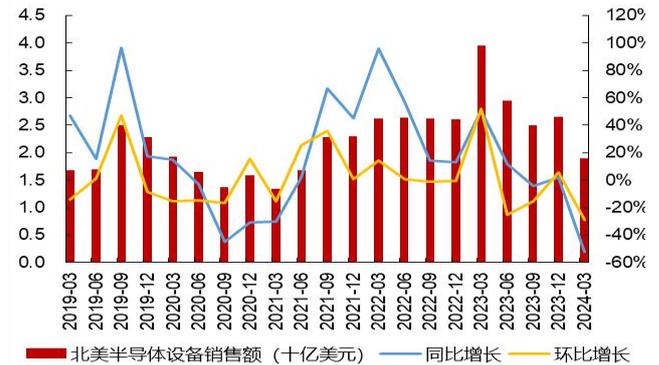
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 13：中国大陆半导体设备销售额



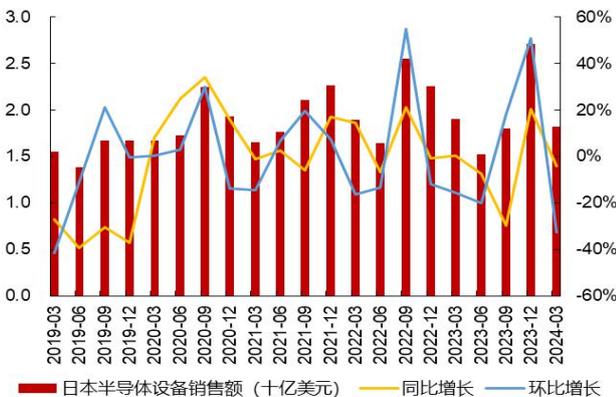
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 14：北美半导体设备销售额



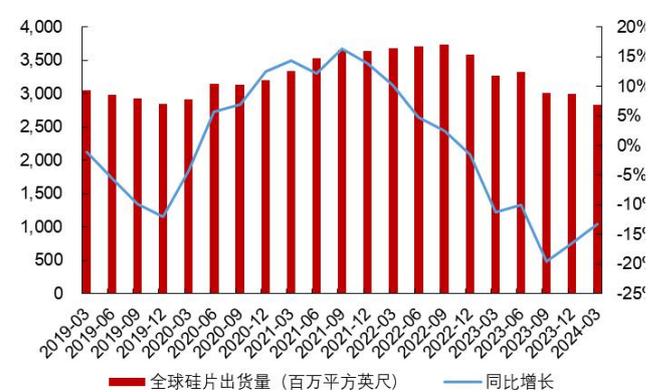
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 15：日本半导体设备销售额



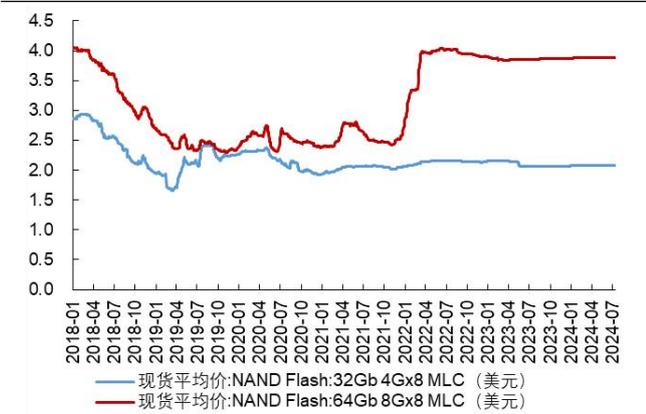
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 16：全球硅片出货面积



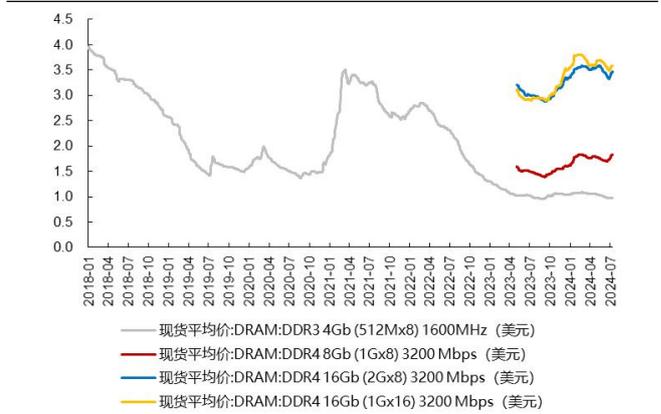
资料来源：SEMI，山西证券研究所

图 17: NAND 现货均价



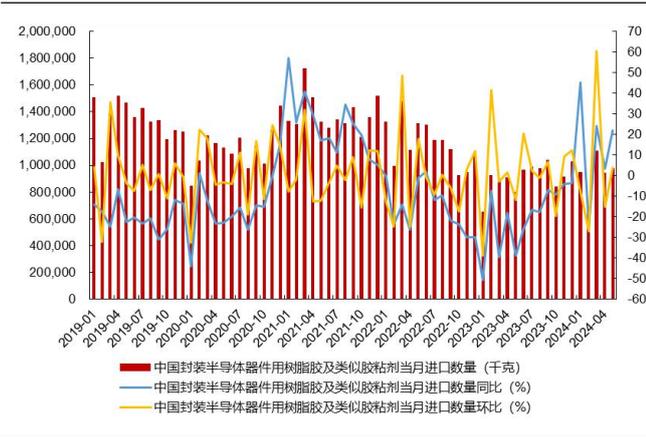
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 18: DRAM 现货均价



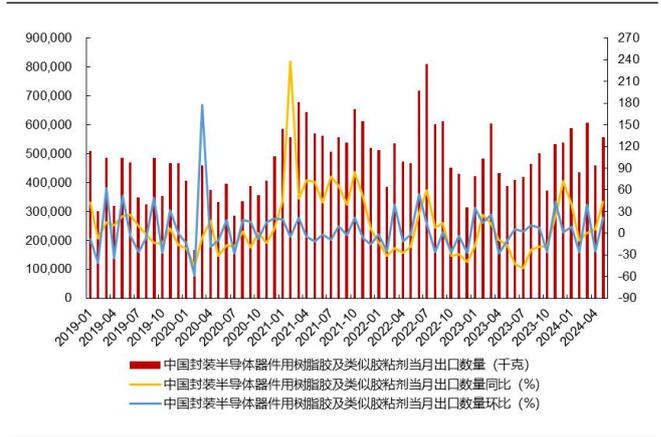
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 19: 半导体封装材料进口情况



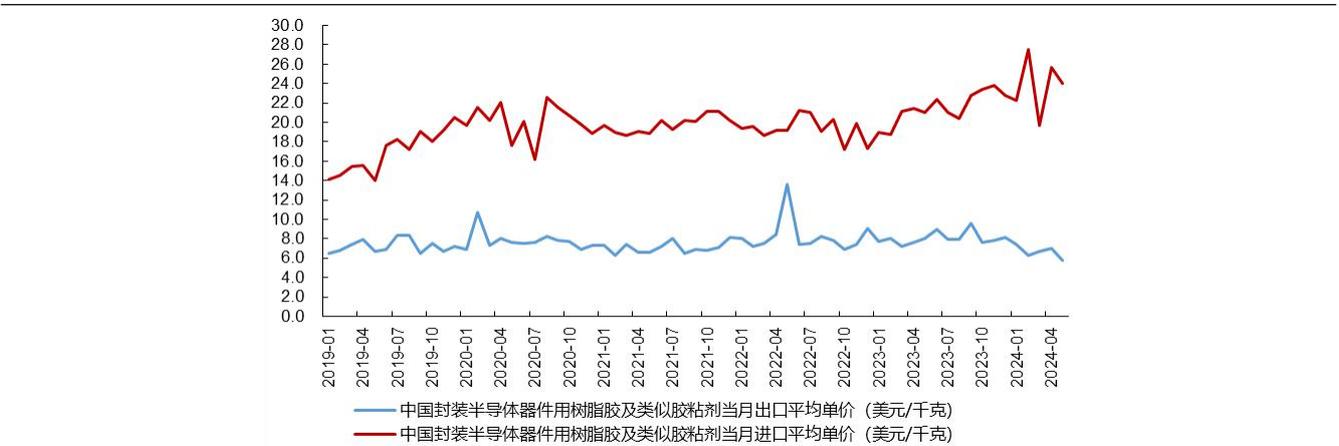
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 20: 半导体封装材料出口情况



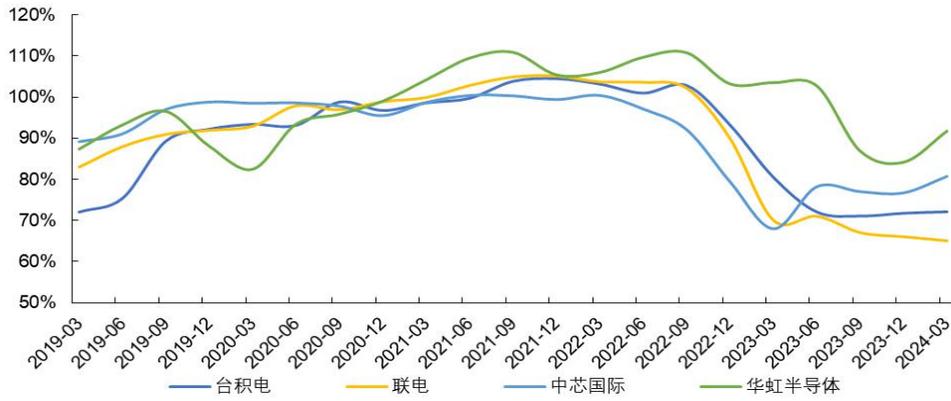
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 21: 半导体封装材料进出口均价



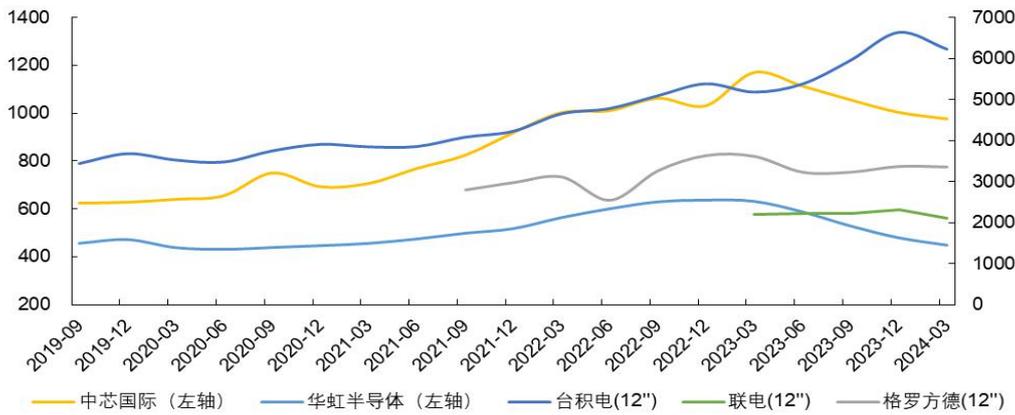
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 22：晶圆厂稼动率（%）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 1：本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024 年 7 月 15 日		富满微		欣旺达	
2024 年 7 月 16 日	传音控股	精研科技、光韵达		华亚智能	华亚智能
2024 年 7 月 17 日			盈方微		

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024年7月18日			寒武纪-U、新亚制程、泰凌微		
2024年7月19日					
2024年7月20日	芯动联科	芯动联科			

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 2：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2024年7月15日	全球智能手机市场连续第三季度实现同比增长，2024年第二季度出货量增长12%，达到2.88亿部。 三星以18%的市场份额继续保持全球领先地位，因为它重新将高端市场作为战略重点。苹果紧随其后，市场份额为16%，排名第二。小米本季度以15%的市场份额紧随苹果之后，以27%的年增长率在前五大厂商中增长最快。VIVO以9%的市场份额排名全球第四。传音在本季度排名第五，市场份额为9%。Canalys研究经理 AmberLiu 表示：“在 GenAI 等创新技术的推动下，全球智能手机市场的乐观情绪继续增强，大众市场的需求也在不断复苏。”	Canalys
2024年7月16日	全球被动元件行业出现新一轮涨价潮 最高涨幅20%。 全球被动元件行业出现新一轮涨价潮，其涨价幅度远超此前几轮，最高涨幅预告达到20%。本次涨幅主要驱动因素是智能手机旺季即将到来、PC市场复苏以及今年白银价格飙升30%以上。村田、TDK和太阳诱电三家电感器制造商，国巨和华新科技集团等都计划提高多层电感器和磁珠的价格，报道预计大尺寸产品将率先涨价，涨幅在10%至20%之间。	金融界
2024年7月17日	美拟对华芯片贸易实施更严厉管制。 彭博社周三报道称，拜登政府正在考虑进行全面打击向中国出口关键芯片制造设备的公司。美国的“外国直接产品规则（FDPR）”允许美国对外国制造的产品进行控制，即使它们使用了最少的美国技术。据知情人士透露，美国正在向日本和荷兰施压，称如果东京电子和ASML等公司继续向中国提供先进半导体技术，美国将考虑采取最严厉的贸易限制措施。为了影响盟国，美国正在考虑是否适用“外国直接产品规则”。作为美国出口管制制度中的一项规则，它允许美国对外国制造的产品实施管制，只要这些产品使用了美国技术。外交部发言人林剑称，希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫，共同维护公平开放的国际经贸秩序，真正维护自身的长远利益。	Bloomberg
2024年7月17日	ASML发布FY2024Q2财报。 ASML第二季度净销售额62.4亿欧元，高于预期的60.3亿欧元，ASML此前预测第二季度净销售额于57亿欧元至62亿欧元之间。净利润15.8亿欧元，高于预期的14.3亿欧元，同比下降18.7%，但较上个季度跌幅有所收窄。二季度订单总额上涨至55.7亿欧元，同比增长超24%以上，高于分析师预期的44.1亿欧元，其中25亿欧元来自极紫外光刻（EUV）系统。公司表示，一些最大客户的强劲业绩帮助支撑了对该公司设备的需求。第二季度毛利率为51.5%，高于预期的50.6%，也高于第一季度的51%。ASML对全年的展望保持不变，预计2024年的总净销售额将与2023年相似，主要得益于下半年强劲的市场表现。预计第三季度净销售额为67亿欧元至73亿欧元，低于市场预期的74.6亿欧元。	ASML官网

时间	内容	来源
	<p>预计第三季度毛利率为 50%至 51%，低于市场预期的 51.1%。ASML 认为 AI 的发展是推动行业复苏和增长的主要动力。在 ASML 新增订单中，EUV 系统订单为其中重要部分，第二季度 ASML 也对 EUV 技术进行了重要更新，在客户的支持下，ASML 表示下半年的出货量有望继续增加。当前，ASML 正在增强与客户间的深度合作，运用 EUV 技术助力 AI 有关的芯片制造。</p>	
2024 年 7 月 17 日	<p>预估 2024 年全球 AI 服务器产值达 1,870 亿美元，约占服务器市场比重 65%。根据 TrendForce 集邦咨询最新发布「AI 服务器产业分析报告」指出，2024 年大型 CSPs（云端服务业者）及品牌客户等对于高阶 AI 服务器的高度需求未歇，加上 CoWoS 原厂台积电及 HBM（高带宽内存）原厂如 SK hynix（SK 海力士）、Samsung（三星）及 Micron（美光科技）逐步扩产下，于今年第 2 季后短缺状况大幅缓解，连带使得 NVIDIA（英伟达）主力方案 H100 的交货前置时间（Lead Time）从先前动辄 40-50 周下降至不及 16 周，因此 TrendForce 集邦咨询预估 AI 服务器第 2 季出货量将季增近 20%，全年出货量上修至 167 万台，年增率达 41.5%。</p>	TrendForce
2024 年 7 月 18 日	<p>台积电发布 FY2024Q2 财报。2024 年 Q2 营收 208 亿美元，高于公司指引上限，超越彭博一致预期，同比增长 40%，环比增长 14%。当季营收上涨，主要原因是 3nm 和 5nm 出货量增长，但智能手机季节性疲弱一定程度抵消了先进制程的增长。得益于 AI 相关和智能手机的强劲需求，公司表示 N3 和 N5 需求在 2024 年整体产能利用率较高，并上调全年美元营收指引至 mid-20%+（此前 low-to-mid20%）。当季毛利率 53.2%，超出公司此前指引上限，同比-0.9ppts，环比+0.1ppts。得益于 AI 和高端智能手机的强劲需求，2024 年下半年 3nm 和 5nm 的产能利用率会继续上升。公司 3nm/5nm/7nm 制程营收占比分别为 15%/35%/17%（24Q1 分别为 9%/37%/19%），先进制程合计占比 67%（24Q1 为 65%）。公司当季 3nm 营收占比提升，主要受 AI 芯片需求的强劲需求带动。台积电表示 N2 工厂建设进展顺利，预计 2025 年实现量产。高性能计算/智能手机/IoT/汽车/消费电子/其他业务营收占比分别为 52%、33%、6%、5%、2%、2%（上季度分别为 46%、38%、6%、6%、2%、2%），其中，高性能计算营收占比首次超过 50%。</p>	台积电官网

资料来源：Canalys，金融界，Bloomberg，ASML 官网，TrendForce，台积电官网，山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。

分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：

——公司评级

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区林创路新一代产业园 5 栋 17 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

